

# 実装基板平面研磨解析



内藤電誠工業(株)

携帯電話等、微細かつ多層配線基板の平面研磨解析が可能です。(※部品取外し等による基板膨らみ、反りが無いもの)

平面研磨により、実装基板の出来栄え確認や構造解析、マイグレーション観察等、幅広い解析に応用可能です。

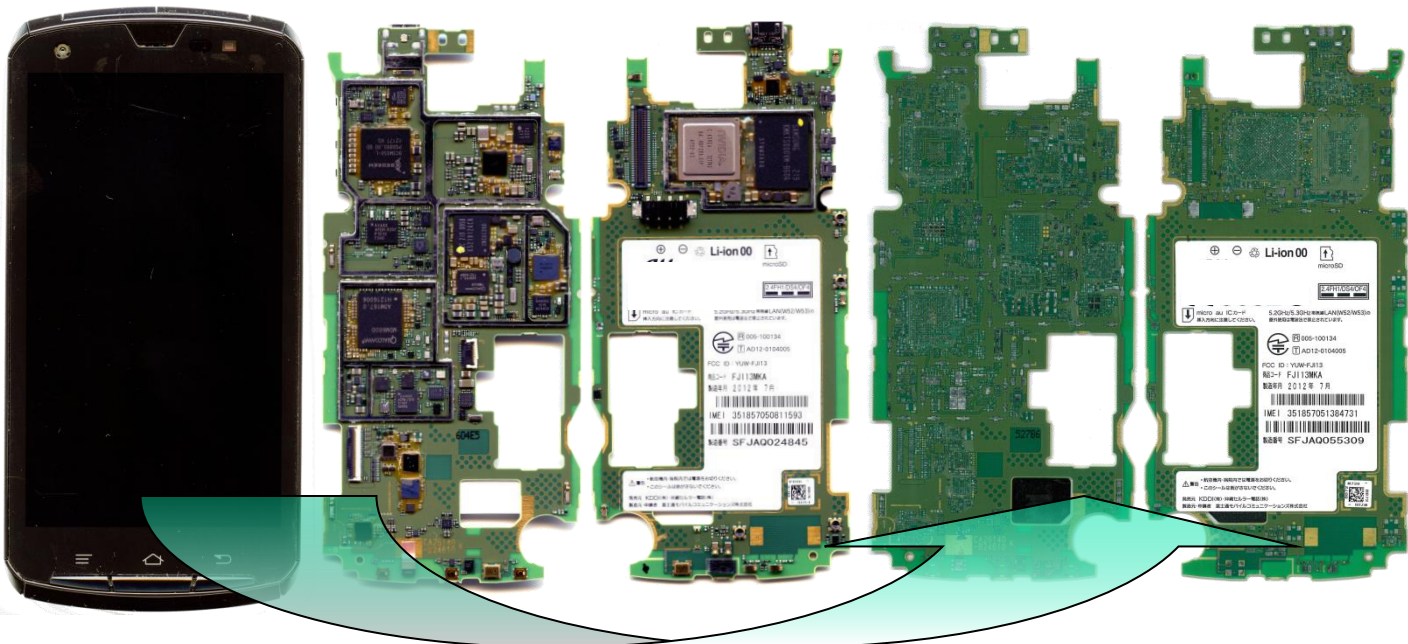
※弊社実績

基板サイズ: 50mm × 80mm

基板厚さ: 724μm

基板層数: 10層

配線幅: 約30μm/層間: 約60μm



## 基板概要

基板サイズ: 60mm × 125mm

基板厚さ : 684μm

基板層数 : 10層

配線幅: 約20μm/層間: 約40μm

## ランド径、配線幅/ピッチ測長

ランド半径 = 141.28 μm

配線ピッチ = 124.23 μm

配線幅 = 59.29 μm

平面研磨

# チップエッチバック解析

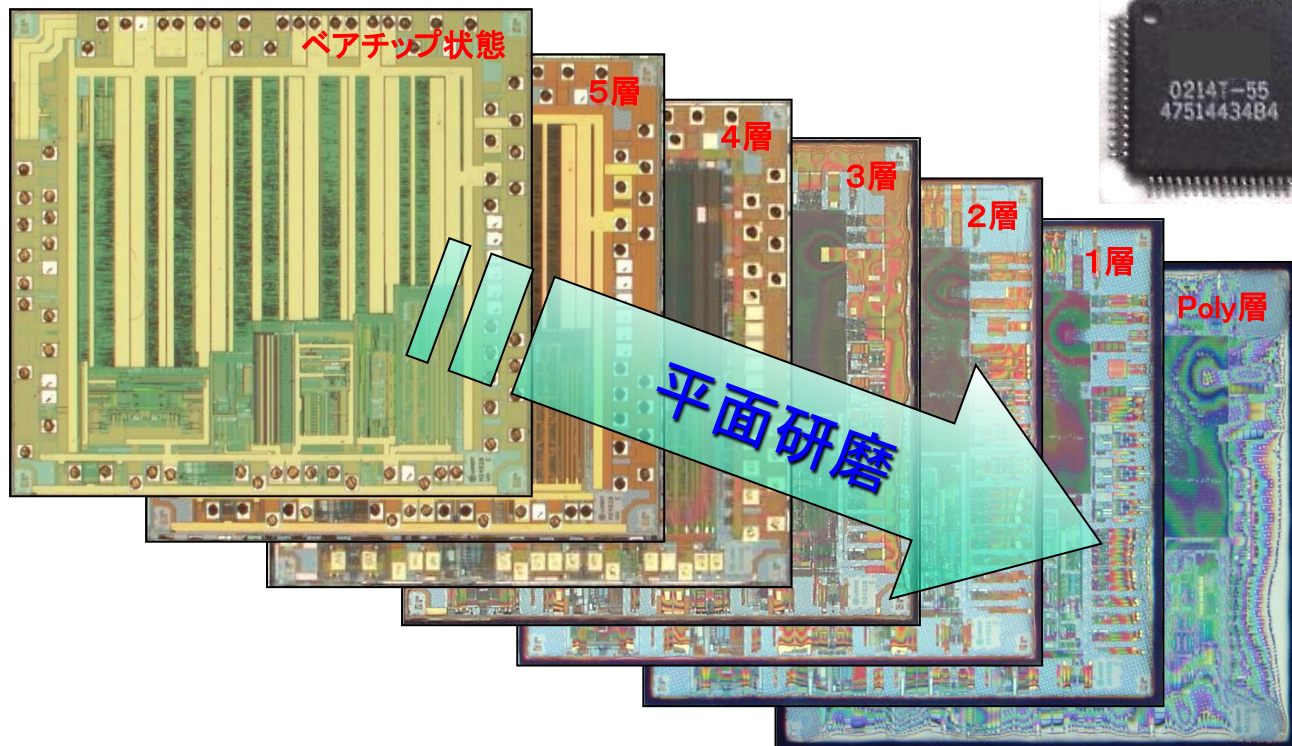
全開封等、ベアチップ化したチップについて平面研磨によるエッチバック解析が実施可能です。

不具合解析や、他社品解析、構造解析等、幅広い調査・解析に応用可能です。



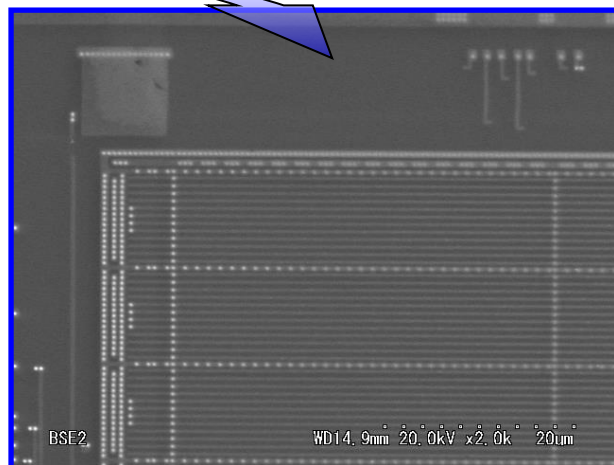
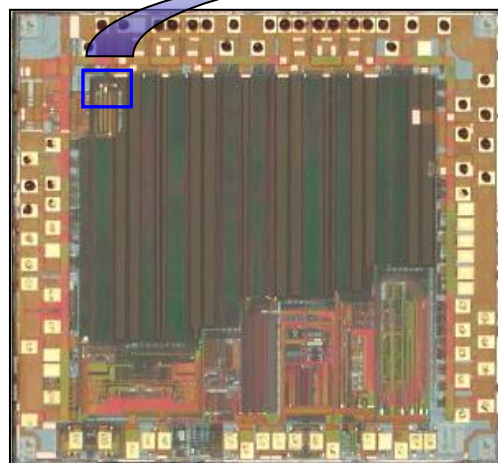
内藤電誠工業(株)

64pinTQFP(□10mm)



(弊社実績:5層品/150nmプロセス、チップサイズ2.15mm×2.0mm)

ディンプルグラインダを使用したスポット研磨解析や、電子顕微鏡(SEM)による高倍率かつ高精細な表面観察も実施可能です。



## 内藤電誠工業株式会社 評価解析事業部

213-0011 川崎市高津区久本3-9-25

TEL:044-811-5496

FAX:044-850-5851

<https://www.lab.ndk-grp.co.jp/>